(19) 日本国特許庁(JP)

の特許出頭公開

昭61-204987 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4 H 01 L 31/10 維別記号

庁内整理番号

63公開 昭和61年(1986)9月11日

6819-5F

審查請求 有 発明の数 1 (全7頁)

半導体発受光装置 の発明の名称

到特 顧 昭60-45796

四出 顧 昭60(1985) 3月8日

厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話公社厚木電気通 (7)発明者 信研究所内 厚木市森の里若宮3番1号 日本電信電話公社厚木電気通

套 69発明.者 信研究所内

日本電信電話株式会社 の出 願 人 弁理士 田中 正治 70代 理 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

2.特許請求の範囲

半導体活性履をそれぞれ含み且つ豆に同じ積 面構造を有する第1、第2及び第3の半準体積 顕体が、それらの順に並置して、それらに共通 の半機体拡板上に形成され、

上記第1、第2及び第3の半導体積層体上に、 第 1 、 第 2 及び第 3 の 電極がそれぞれ付され、 上記半導体 基板に、上記第1、第2及び第3 の電極に対して共通な共通電極が付されている 構成を有し、

上記第1の半導体積層体の半導体活性層が、 上記第2の半導体積層体の半導体活性層に比し

狭いエネルギバンドギャップを有し、 ト記第2の半導体積層体の半導体括性層が、 上記第3の半導体積層体の半導体括性層に比し

狭いエネルギバンドギャップを有し、 上記半導体技板と、上記第1の半導体積層体 と、上記第1の徴権と、上記共通電極とで、上

記算1の半導体積層体の半導体活性層のエネル ギバンドギャップによって決められた第1の波 長を有する光を発光または受光し得る第1の半 進化なる米菓子が構成され、

上記半導体基板と、上記第2の半導体積層体 と、上記第2の。電桶と、上記共通電板とで、上 記第2の半導体積層体の半導体活性層のエネル #パンドギャップによって決められた上記第7 の数長に比し短い第2の数長を有する光を発光 または受光し得る第2の半導体発受光素子が弱

上記半導体基板と、上記第3の半導体積層体 と、上記第3の電極と、上記共通電極とで、上 記憶3の半導体格層体の半導体活性層のエネル ギバンドギャップによって決められた上記第2 の被長に比し短い第3の被長を有する光を発光 または受光し得る第3の半導体発受光索子が構 成されていることを特徴とする半導体発受光装 a.

3. 発明の詳細な説明

初開昭61-204987(2)

産業上の利用分野

従来の技術

従来、別1(または前2)の数長を有する光 を、光ファイバを用いて他の収置に選信させ関 もように、見光きせながら、それと同時に、節 2(または第1)の変長を有する光を、光ファ イバを用いて他の度置から受信させ得るように、 実光させることができる、という実用的な平時 体発受光質質の異変はみられていない。

発明が解決しようとする問題点

このため、第1(または第2)の数長を有する光を、光ファイバを用いて他の位置に送信させ得るように、発光させながら、それと同時に、

第2(または第1)の数長を行する光を、光ファイバを用いて他の設置から受信させ得るように、受光させる場合、従来は、第1(またはいて他の位置に送信させ得るように、見光させ得る半導体兄光装置と、第2(は本は第1)の数長を行する光を、光ファイバを用いて他の位置から受信させ得るように、受光させ得る半導体受発とを再せた。

このため、従来は、第1(または第2)の設 長を有する光を、光ファイバを用いて他の位置 に返信させ群らように、見光させながら、それ と同時に、第2(または第1)の変長を有する 光を、光ファイバを用いて他の位置から受称さ 世符るように、受光させるための装置が、全体 として、大型、森陽になる、などの欠点を有し ていた。

また、従来は、上述した半導体発光装置と、 上述した半導体受光装置とを用いて、第1(または第2)の競逐を有する光を、光ファイバを

用い他の位置に送信させ得るように、発光させ ながら、それと同時に、第2(または第1)の 波長を有する光を、光ファイバを用いて他の位 置から受信させ符るように、受光させることが できるとしても、上述した半導体発光装置から 発光して得られる第1(または第2)の被長を 有する光を光ファイバを用いて他の位置に送信 させ、また、光ファイバを用いて、第2(また は第1)の被長を有する光を、他の位置から、 上述した半導体受光装置に受信させる場合、送 信用の光ファイバと、受信用の光ファイバとを 必要とするか、または送受信用の光ファイバと、 その送受信用の光ファイパと、上述した半導体 発光装置と上述した半導体受光装置とのそれぞ れとの間の2つの光結合路とを必要としていた。 このため、従来は、第1(または第2)の故 長を有する光を、光ファイバを用いて他の位置 に送信させ得るように、発光させながら、それ

と同時に、第2(または第1)の被長を有する

光を、光ファイバを用いて他の位置から受信さ

せるようにし、そして、第1(または第2)の 数反を有する光を、光ファイパを用いて他の位 数に延信させ、また、光ファイパを用いて他の位 位置から、第2(または第1)の数長を有する 光を受信させるようにするための装置が、全体 として、大型、高額になる、などの欠点を有し ていた。

問題を解決するための手段

35開昭61-204987 (3)

狒体発受光装置を提案せんとするものである。 本発明による半導体発受光装置は、半導体活 体 屋 をそれぞれ含み且つ互に同じ積磨構造を有 する第1、第2及び第3の半導体積層体が、そ れらの順に並置して、それらに共通の半導体禁 板上に形成され、また、上記第1、第2及び第 3の半導体積層体上に、第1、第2及び第3の 電権がそれぞれ付され、さらに、上記半導体基 板に、上記第1、第2及び第3の電板に対して 共通な共通電極が付されている構成を有し、そ して、この場合、上記第1の半導体積層体の半 準体活性層が、上記第2の半導体簡層体の半導 体活性器に比し狭いエネルギバンドギャップを 有し、また、上記第2の半導体積層体の半導体 哲性層が、上記第3の半導体積層体の半導体

活性層が、上記第3の半導体

積

層体の半導体

活
 性層に比し狭いエネルギバンドギャップを有し、 よって、上記半導体基板と、上記第1の半導体 機関体と、上記第1の電極と、上記共通電板と で、上記第1の半導体積敷体の半導体活性層の エネルギバンドギャップによって決められた第

fi fi

このような構成を有する本発明による半導体 発受光装置の場合、第1、第2及び第3の半導体発受光素子が、それらの順に並置して配列されている機能を有する。

また、 第 1 、 第 2 及び 第 3 の 半 導体 発受光素 子のそれぞれ を構成している 第 1 、 第 2 及び 第 3 の 半 導体 様 顧 体 の 半 導体 活 性 園 の エ ネ ル ギ バ ン ド ギ ャ ッ ア を、 そ れ で れ ら エ ネ ル ボ ハン ド ギ ャ ッ ア E の 3 、 E の 5 2 入び E の 3 が、 E の 1 、 E の 2 及び E の 3 が、 E の 1 、 E の 1 、 E の 2 、 < E の 3 の 面 係 を 布 する & 。

さらに、第1、第2及び第3の半導体発変光 乗子がそれぞれ発光または変光し得る第1、第 2及び第3の光を、それぞれし1、し2及びし 3とし、そしてそれら光し1、し2及びよ3の 酸長を、それぞれ入1、入2及び入3とすると き、それら 数段入1、入2及び入3が、入1> 入2>入3の関係を有する。

このため、いま、第1の半導体発光素子で 変長入りを有する光し」を見光させれば、その 光し1が第2及び前2の半導体発光が第2及 たんど吸収されることなりに、前2及び第3の 半導体発光素子をそれらの順に適つで、第1 の半導体程光素子質とは反対側から外部に出 の半導体程光素子類とは反対側から外部に出 N + & . .

また、第3の平場体界受光素子の第1の平場体界受光素子側とは反対側から、第1の平場体 段受光素子側とは反対側から、第1の平場体 及受光素子側に向けて被長 23をとしたが第3の 平導体界受光素子の表しまかはとんが第3の 平導体界受光素子の表しまかは、第3の電板 数反大調画環板を力して、出力される。

さらに、第3の半時体発受光素子で被兵入3 を有する光し3を飛光させれば、その光し3が、 第1の半導体発受光素子倒とは反対側から外部 に出射する。

この場合、被長入₃を有する光し3は、第1 の半導体発受光無子側にも向うが、その光し3 は、第2の半導体発受光素子でほとんど吸収さ れるため、第1の半導体発受光素子にほとんど がしない。

また、第3の半導体発受光素子の第1の半導体発受光素子側とは反対側から、第1の半導体発受光素子側に向けて、波長31を有する光し

3 を入射させれば、その光し, が、第3及び第 2の平滑体及受光素子ではとんど吸されることなしに、第3及び第2の平滑体及受光素子 となりに、第3力ので、第1の平滑体及受光素子 に入射し、そして、その第1の平滑体及受光素 子で吸収され、その批型、被反入, を有する光 11の受光出力が、第1の常権及び共通電極を 介して出力される。

Ø) T

このため、木児明による事物体及変光報理とれば、第1(または第2)の設度を有する光(上例の場合、数度入1を有する光し、(または数度入3を有する光し、3))を、光ファイバを用いて他の設置に監視させ得るように、見免せながら、それと同時に、第2(または第1)の設度を有する光(上例の場合、数度入3を有する光し、1)と、光ファイバを用いて他の位置から受信させのように、変光ませることが下きる。

しかも、この場合、第1(または第2)の被

反を有する鬼(L 例の場合、故區 λ , を有する λ , 化 λ , 化 λ , 化 λ , λ

美通例

次に、第1回を作なって本発明による半導体 発受光装置の実施例を述べよう。

第 1 図に示す本発明による半導体発受光核理は、次に述べる構成を有する。

すなわち、例えばInPでなり且つn型を行する半導体基板10を行し、その半導体基板10と行し、その半導体基板10上に、例えばInPでなり口つn型を育する

バッファ筋乃至クラッド超としての半導体府2 1と、例えばInGaAsP系でなり目つ半線 外間21に比し十分低い不能振動度をおする出 導体活性脳22と、その半導体活性腱22より も僅かに広いエネルギバンドギャップを有する **削えば I n G a A s P 系でなり且つ半導体数 2** 1 に比し十分低い不動物濃度をおする通過路隔 としての半導体層23と、解えば1nPでなり 日つ D 型を有するクラッド 図としての半週 体質 24とが、それらの順に格闘されている、とい う構成を有する第1、第2及び第3の半導体格 粉体81、82及び83が、それらの順に並習 して形成され、一方、それら半機体粘膜体内1. B2及びB3上に、第1、第2及び第3の電板 E 1、E 2 及びE 3 ルモれぞれオーミックに付 され、また、半導体組板1に、半導体積縮体B 1、B2及びB3側とは反対側の面上において、 **徴極E1、E2及びE3に対して共通な電極E** O がオーミックに付されている構成を有する。 この場合、半導体格額体 В 1 、 В 2 及び В 3

の半導体括性粉22は、それらのエネルギバン ドギャップをそれぞれEg₁、Eg₂及びEg 。とするとき、それらエネルギバンドギャップ E 0 1 . E 0 2 & U E 0 3 15 . E 0 1 < E 0 2 < E O a の関係のエネルギバンドギャップを有 し、よって、半導体駐板10と、半導体積層体 B1と、電板E1と、共通電板EOとで、半線 体務額体目1の半導体活性数22のエネルギバ ンドギャップEG」によって決められた第1の 故長え、を有する光し、を発光または要米し段 る第1の半導体発受光 名子M 1 が構成され、出 た、半導体基板10と、半導体積縮休B2と、 常様 F2と、 共通 岩板 FOとで、 半週 休格 数 体 B2の半導体活性間22のエネルギバンドギャ ップEggによって決められた第1の波長え。 を有する光し。を発光または受光し得る第2の 半導体発受光素子M2が構成され、さらに、半 導体 基板 10と、半導体 植粉体 B3と、間板 F 3 と、共通電板EOとで、半導体積層体B3の 半導体活性層22のエネルドバンドドャップE

初期前61-204987 (5)

りょによって決められた第1の数長入るを有す る光し、を発光または受光し得る第3の半導体 我母光素子M3が構成されている。 なお、上述した構成を有する本発明による半 導体発受光装置は、実際上、次に述べる構成を 有する。 すなわち、半導体排板10上に、半導体積層 休日1~日3の半導体数21になる半導体数3 1 が形成され、その半導体層3 1 上に半導体積 助休日1、日2及び日3の半導体活性置22が それらの順に並習して形成され、そして、半機 休慰31上に、半導体級関体B1~B3の半枠 体活性暦 2 2 を埋置して、半導体積度休 B 1 ~ B3の半導体層23になる半導体層33と、半 導体積層体B1~B3の半導体置24になる半 導体層34とがそれらの順に形成され、しかし て、半導体層31、33及び34からなる半導 体積層体内に、その上方からプロトンの照射に よって、ト方からみて、半導体層31、33及 び34からなる半導体積層体を3分するように、 絶経暦112、及び123が、半導体積層体目 1 及 15 B 2 の 半 準 体 紙 析 版 2 2 届 。 及 15 半 準 体 林郷休日2及び日3の半項休託件間22間にお いて、ともに半導体製板10に達する深さに形 成され、よって、半導体器31、33及び34 からなる半導体積縮体の、絶縁断112からみ て絶縁関123側とは反対側の領域を、半導体 活性概22を含んでいる半導体務関体B1とし、 また、半週休期31、33及び34からなる半 神体積懸体の、絶縁照112及び123回の類 罐を、単脚体活件防クラを含んでいる半導体積 顕体 B2とし、さらに、半導体 頗 3 1 、 3 3 及 び3.4からなる半週休務関係の、終録期123 からみて絶縁器112個とは反射側の領域を、 半導体話性層22を含んでいる半導体積層体目 3としている構成を有する。

以上が、本発明による半線体発受光装置の実施例の構成である。

このような構成を有する本発明による半導体 発受光装置の場合、第1、第2及び第3の半機

体発受光素子M1、M2及びM3がそれらの順に並習して配列されている構成を有する。 また、第1、第2及び第3の半準体発受光素

子 M 1、 M 2 及び M 3 の 干れぞれを構成している 第 1、 第 2 及び 第 3 の 平 準 体 研 順 4 日 1、 B 2 及び B 3 の 平 準 体 は 世 照 2 で エ ネルギバンド ギャップ E で 1、 E で 2 及び E D 2 が 、 E の 、 < E で 。 < E で 。 ○ 関 顔 を 有 する。

このため、いま、第1の非導体現実光素子M 1の電板E1及びE3間に、電板E1開発正と する電源を接触し、その半導体現実光素子M 1 で放斥入1を有する光し1を現光させれば、そ の光し1が第2及び第3の半導体現実光素子M 2及びM 3でほとんど吸収されることなしに、 2及びM 3でほとんど吸収されることなしに、 2及びM 3ではとんど吸収されることなしに、 2及びM 3のよ をそれらの順に通って、第1の半導体発受光素 子M1個とは反対側から外部に出射する。

また、第3の平海体及炎光素子M3の電極区 3及びE0間に、電梯区3 解を負とする電報を接続して、また出接株することなしに、平海体及炎光素子M3の半導体及炎光素子M1間に向けて破長入3を有する光し3を入りさせれば、その光し、がほとんど第3の半導体及麦光素子で吸収され、その転収、数長入3を有する光し3の変光出力が、第3の電格及び共適電極区0を介して、出力される。

さらに、第3の平準体界受光集子M3の電板 E3及びE0間に、電板E3解を正とする電報 を接続し、半導体界受光業子M3で装度 A3を 有する光L3を発光させれば、その光L3が、 和1の半導体界受光素子M1割とは反対側から 外部に出射する。

この場合、彼長 λ_3 を有する光 L_3 は、第 1 の半 準体 発受光素子 M 1 側に も向うが、その光

独開報61-204987 (6)

し 3 は、第2の半導体充受光素子M2でほとんど吸収されるため、第1の半導体発受光素子にほとんど入射しない。

このため、第1回に示す本発明による平等体 発受光装置によれば、第1(または第2)の被 吸を有する光(上例の場合、数長 λ1 を有する 光し」(または波艮え)を有する光しる))を、 *ファイバを用いて他の位置に送信させ得るよ うに、第1(または第3)の半導体発受光素子 M1(またはM3)で、発光させながら、それ と同時に、第2(または第1)の被長を有する 光(上側の場合、波長えるを有する光しる(ま たは被長み,を有する光し1))を、光ファイ パを用いて他の位置から受信させ得るように、 第3 (または第1) の半導体発受光素子M3 (またはM1)で、受光させることができる。 しかも、この場合、第1(または第2)の波 長を有する光(上側の場合、披長入りを有する 光し」(または彼長入るを有する光しる))を、 光ファイバを用いて他の位置に送信させ、また、 米ファイパを用いて、第2(または第1)の被 長を有する光(上桝の場合、波長入っを有する 光しる(または披長入りを有する光しり)を受 信させる場合、第2因において、第1因で上述 した本発明による半導体発受光装置の2つをU 1及びU2として用い、そしてそれら半導体発

受光装置U1及びU2回を1本の送受信用の光 ファイバFで結合していることが示されている ように、送信用の光ファイバと、受信用の光フ ァイパとの2本の光ファイパを必要とせず、送 受信用の1つの光ファイバで足り、また、その 送受信用の1つの光ファイバとの間に2つの光 統合路を必要とせず、1つの光結合路で足りる。 また、上述したように、波長入り(または入 3)を有する光し1 (またはし3)を、第1 (または第3)の半導体発受光素子M1(また はM3)で発光させながら、それと同時に被長 え。(またはえ、)を有する光し。(またはし ,)を、第3(または第1)の半導体発受光素 子 M 3 (または M 1) で 受光させるとき、第2 の半導体発受光素子M3の電板E2及びEOを 短絡させておくことによって、雑音を実質的に 伴わしめることなしに、上述した発光及び受光 を行わせることができる、という優れた特徴を 有する。

なお、上述においては、本発明による半導体

発受光装置の1つの実施例を示したに留まり、 水発明の精神を脱することなしに、種々の変型、 変更をなし得るであろう。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、本発明による半導体発受光装置の 家施器を示す略線的新面図である。

30 2 回は、第1 回に示す本発明による半導体 免受光装置を用いて、双方向通信を行い得ることを示す略線的系統図である。

- 10 半導体並板
- B 1 , B 2 , B 3
 - 平 導 体 積 層 体
- 2 2 半導体活性層
- E1、E2、E3
- E O … … … 共 通 電 様
- M 1 . M 2 . M 3
 - 半 導 体 発 受 光 素 子





